

32.01 PGA-Fassung Serie 510/Serie 514 SMD PGA-Fassung Serie 516 VERY HIGH

Die PGA-Fassungen werden in verschiedenen Ausführungen geliefert.

Isolierkörper:

1. Thermoplastischer Polyester
Lötbeständigkeit 260° C, 10 Sekunden
 2. Thermoplastischer Polyester mit Abstandsnoppen, Lötbeständigkeit 260° C, 10 Sek.
 3. Epoxyd EP-GC 02
Lötbeständigkeit 260° C, 20 Sekunden
- Höchste Kontaktsicherheit durch 6-Lamellen-Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung.

Finden Sie Ihr Layout nicht auf den Seiten 32.05 - 07, senden Sie uns bitte Ihr Bauteil.

Kontaktfeder

Material: Beryllium-Kupfer
Oberfläche: Nickel 2 – 3 µm, Gold 0,25 µm, 0,75 µm Gold flash

Hülse

Material: Messing gedreht
Oberfläche: Nickel 2 – 3 µm, Zinn 5 µm (SnPb 90/10)

Isolierkörper hochtemperaturfest (HT)

Thermoplastischer Polyester glasfaserverstärkt, oder Glasfaser Epoxyd EP-GC 02, nach DIN 40802 (FR4 Lema L11), 35 µm Kupfer, selbstverlöschend nach UL94V0.

Temperatur

Betriebstemperatur -55 bis +125° C
Lötbeständigkeit 260° C, 10 Sekunden

Kontakttiefe

2,4 mm bei sicherer Kontaktgabe

Einsteckdurchmesser

min. 0,4 mm, max. 0,56 mm

Betriebsspannung

100 V_{RMS}

150 VDC

Durchschlagsspannung

1000 V_{RMS}

Isolationswiderstand

10¹⁰ Ω

Durchgangswiderstand

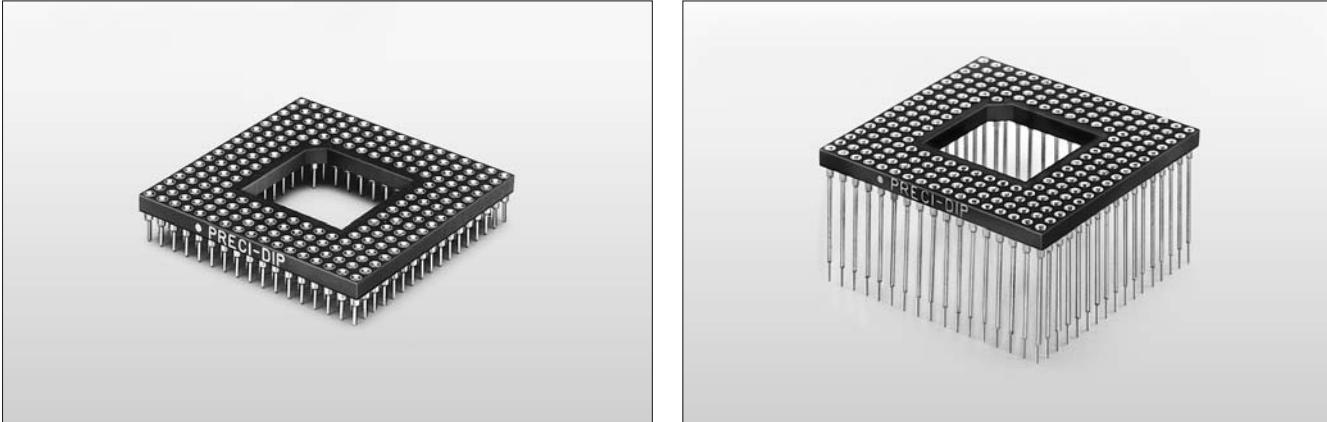
≤ 10 mΩ

Luft- und Kriechstrecke

> 0,6 mm

Kapazität

< 0,3 pF



Für Stift Ø 0,4 bis 0,56 mm □ 0,25 x 0,45 mm		Hülse	5 µm Zinn	5 µm Zinn	5 µm Zinn
		Feder	Gold flash	0,25 µm Gold	0,75 µm Gold
L	Y	Bestell-Nr.			
	6	510-97-XXX-XX-XXX-001	510-91-XXX-XX-XXX-001	510-93-XXX-XX-XXX-001	
Standard					
Stand-Off					
Isolierkörper Epoxyd EP-GC 02					
Very High					
SMD					

Mit Abstandsnoppen
Der Luftspalt zwischen der Leiterplattenbohrung und dem Kontakt gewährleistet ein besseres Aufsteigen des Lötzinns durch die Bohrung.
Standardprodukt - Artikel-Nr. auf Anfrage.

Mit Epoxyd-Isolierkörper -
Artikel-Nr. auf Anfrage

XXX-XX-XXX = Layout (Seite 32.05 bis 32.07)

Y = Anzahl der Lamellen